

**NEWS ANNOUNCEMENT**

FOR IMMEDIATE RELEASE

※本リリースは 2022 年 6 月 8 日に発表されたリリースを訳したものです

**タワーセミコンダクターがシリコンフォトニクスの主要プロセスと PDK の特徴について紹介**

**ウェビナーでは、タワーの PH18 プロセスで PIC 設計のためのエンドツーエンド設計フローのデモを紹介**

ミグダル ハエメク、イスラエル、2022 年 6 月 8 日 - 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリである[タワーセミコンダクター](#) (NASDAQ/TASE:TSEM)は、本日、「**レーザー統合型シリコンフォトニクスプラットフォームを用いた設計の開発と検証**」と題するウェビナーの開催を発表しました。技術部門とデザインイネーブルメント部門の専門家が主催するこのウェビナーは、タワーの PH18 プロセスの主要なプロセスとプロセスデザインキット(PDK)の特徴を紹介します。参加者は、フォトニック集積回路(PIC)設計用の Synopsys 製品を用いたエンドツーエンド設計フローのデモンストラーションに加えて、InP ベースの集積レーザー、増幅器、変調器、光検出器を備えた OpenLight の画期的な技術が組み込まれた、タワーのシリコンフォトニクスプラットフォームについて理解することができます。このプラットフォームは、データコム、テレコム、LiDAR、ヘルスケア、HPC、AI、および光コンピューティングアプリケーションを対象としています。

光トランシーバ市場が 400Gb/s から 800Gb/s に移行するにつれて、エネルギー効率とコスト効率の良い光モジュールを組み立てるために多くの複雑なアナログ部品が必要となります。このウェビナーでは、統合レーザーの協調シミュレーションと合成に焦点を当てた、正確な PIC 設計開発の手法を示すために、800G-DR8PIC 設計のケーススタディを取り上げる予定です。ウェビナーでは、統合レーザーを搭載した OpenLight のシリコンフォトニクスプラットフォーム、および Synopsys OptoCompiler™、Synopsys OptSim™、Synopsys PrimeSim™、Synopsys IC Validator™製品で構成される業界唯一の統合された電子およびフォトニクスデザインソリューションとともに、タワーの PH18 プロセスの主要プロセスと PDK の特徴を紹介します。これらのソリューションと手法は、パフォーマンスとスケーラビリティの向上に役立つと同時に、世界で最もエキサイティングで成長を続ける市場の設計コストを削減できます。800G-DR8PIC の例は、シリコンフォトニクスの恩恵を受けることができる他のアプリケーション用の PIC を開発するために外挿可能です。

ウェビナーは 2022 年 6 月 28 日に開催され(下記スケジュール参照)、参加には事前登録が必要となります。

## Develop and Verify Designs Using a Silicon Photonics Platform with Integrated Lasers

### レーザー統合型シリコンフォトニクスプラットフォームを用いた設計の開発と検証

Session 1 – China 11:00am | Japan 12:00pm

Session 2 – USA PST 9:00am | Europe (Germany) 6:00pm

#### Speakers:

Jae Shin	Director of Design Enablement, <b>OpenLight</b>
Daniel Sparacin	VP of Business Development & Strategy, <b>OpenLight</b>
Luis Orbe	Customer Support Coordinator, Photonic Solutions, <b>Synopsys</b>
Samir Chaudhry	Sr. Director, Design Enablement, <b>Tower Semiconductor</b>

詳しい内容や参加登録については、[イベントウェブページ](#)をご覧ください。

#### タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドライダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点があり、イタリアに設立されている 300mm ファブを ST と共有しています。詳細は <http://www.towersemi.com/> をご覧ください。

###

**Tower Semiconductor Company Contact:** Orit Shahar | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**Tower Semiconductor Investor Relations Contact:** Noit Levy | +972-4-604-7066 | [noitle@towersemi.com](mailto:noitle@towersemi.com)